

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2024-043

浙江东尼电子股份有限公司 关于上海证券交易所监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于浙江东尼电子股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】3487 号，以下简称“《监管工作函》”）。

公司按照《监管工作函》的要求，积极组织有关各方对涉及的问题进行了逐项分析和研究，结合公司的实际情况，现将回复内容公告如下：

如无特别说明，本回复中的简称与《东尼电子 2024 年半年度报告》的简称具有相同含义。本回复中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，这些差异均由于四舍五入造成。

1.公告显示，2023 年、2024 年半年度公司归母净利润分别为-6.07 亿元、-0.67 亿元，亏损主要系针对存货计提大额资产减值损失，其中 2023 年计提存货跌价准备 4.63 亿元，2024 年半年度再次计提 1.15 亿元，合计达 5.78 亿元。截至 2024 年 6 月末，公司库存商品、半成品账面价值仅有 1.21 亿元、0.99 亿元，而相应的跌价准备则分别高达 3.34 亿元、0.99 亿元。

请公司补充披露：（1）分产品类别和应用领域列示 2023 年末、2024 年 6 月末公司库存商品、半成品的具体构成和变动情况；（2）结合 2023 年以来主要产品的销售情况，说明各产品类别存货减值迹象出现的具体时点，各季度存货跌价准备的计提依据和测算过程，说明 2023 年至 2024 年半年度存货跌价计提是否及时、充分；（3）结合现有业务开展情况，说明相关存货是否存在进一步减值风险，如是请充分提示。请年审会计师对 2023 年度相关事项发表意见。

【公司回复】

（1）分产品类别和应用领域列示 2023 年末、2024 年 6 月末公司库存商品、

半成品的具体构成和变动情况

1、公司 2023 年末、2024 年 6 月末的库存商品、半成品具体构成如下：

单位：万元

报告期	存货项目	产品类别和应用领域	账面余额	存货跌价准备	账面价值
2024 年 6 月末	库存商品	消费电子	3,654.92	172.10	3,482.82
		光伏	2,813.13	1,670.12	1,143.02
		新能源	3,299.36	168.69	3,130.67
		医疗	741.48		741.48
		半导体	34,982.63	31,397.00	3,585.63
		合计	45,491.52	33,407.91	12,083.61
	半成品	消费电子	1,033.99	41.09	992.90
		光伏	8,400.81	2,429.52	5,971.29
		新能源	1,870.99	202.43	1,668.55
		医疗	661.49		661.49
		半导体	7,962.88	7,313.91	648.97
合计		19,930.16	9,986.96	9,943.20	
2023 年末	库存商品	消费电子	3,438.10	181.48	3,256.62
		光伏	3,187.15	2,313.99	873.16
		新能源	2,883.87	100.99	2,782.88
		医疗	869.54		869.54
		半导体	26,742.48	20,142.56	6,599.92
		合计	37,121.13	22,739.02	14,382.12
	半成品	消费电子	1,346.33	20.04	1,326.29
		光伏	7,916.26	2,636.11	5,280.16
		新能源	1,683.66	202.59	1,481.07
		医疗	821.96		821.96
		半导体	7,558.06	5,757.01	1,801.05
合计		19,326.28	8,615.75	10,710.53	

2、公司 2023 年末、2024 年 6 月末的库存商品、半成品变动情况如下：

单位：万元

存货项目	产品类别和应用领域	2024 年 6 月末 账面余额	2023 年末账面 余额	变动金额	变动比例 (%)
库存商品	消费电子	3,654.92	3,438.10	216.82	6.31
	光伏	2,813.13	3,187.15	-374.02	-11.74
	新能源	3,299.36	2,883.87	415.49	14.41
	医疗	741.48	869.54	-128.06	-14.73
	半导体	34,982.63	26,742.48	8,240.15	30.81
	合计	45,491.52	37,121.13	8,370.39	22.55
半成品	消费电子	1,033.99	1,346.33	-312.34	-23.20
	光伏	8,400.81	7,916.26	484.55	6.12
	新能源	1,870.99	1,683.66	187.33	11.13
	医疗	661.49	821.96	-160.47	-19.52
	半导体	7,962.88	7,558.06	404.82	5.36
	合计	19,930.16	19,326.28	603.88	3.12

(2) 结合 2023 年以来主要产品的销售情况，说明各产品类别存货减值迹

象出现的具体时点，各季度存货跌价准备的计提依据和测算过程，说明 2023 年至 2024 年半年度存货跌价计提是否及时、充分

1、公司 2023 年以来主要产品分类别销售情况如下：

单位：万元

主要产品	2024 年第二季度	2024 年第一季度	2023 年第四季度	2023 年第三季度	2023 年第二季度	2023 年第一季度
消费电子	18,325.26	19,508.66	27,274.96	30,652.41	15,001.53	14,400.72
光伏	6,991.54	5,955.35	8,254.58	13,350.87	12,743.75	10,811.48
新能源	7,233.38	6,640.92	4,998.43	4,412.60	3,312.72	2,101.44
医疗	3,464.30	2,728.31	2,783.92	3,060.41	3,136.65	2,252.87
半导体	1,225.84	2,903.50	1,935.57	75.81	8,495.43	2,434.10
合计	37,240.31	37,736.75	45,247.46	51,552.10	42,690.08	32,000.62

2、公司 2023 年以来各产品类别各季度的存货跌价准备期末余额如下：

单位：万元

主要产品	2024 年 6 月末	2024 年 3 月末	2023 年末	2023 年 9 月末	2023 年 6 月末	2023 年 3 月末
消费电子	311.56	255.56	344.24	158.94	182.22	202.79
光伏	5,477.11	6,331.67	7,129.81	2,077.86	2,245.84	3,448.89
新能源	404.68	414.79	535.10	271.43	289.26	324.82
医疗						
半导体	45,093.23	39,570.25	38,718.59	28,192.36	2,560.38	4,409.14
合计	51,286.58	46,572.26	46,727.73	30,700.59	5,277.71	8,385.64

公司主要产品存货减值迹象出现的具体时点分析如下：

公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，每季度末进行存货跌价准备的测算和计提，公司存货跌价准备主要在半导体和光伏业务。

半导体业务系 2023 年初开始批量供货的新项目，2023 年第三季度因客户检测设备更换，主营业务收入出现下滑，且部分在产品只能作为低等级的调机片处理，相比正常合格品订单售价大幅下降，该业务于 2023 年第三季度计提大额存货跌价准备；2023 年第四季度至 2024 年第二季度该业务仍有存货跌价准备的计提主要系 2024 年公司碳化硅衬底的售价下降且当期产品良率不稳定、生产成本偏高所致。

光伏业务的主营业务收入在 2023 年前三季度呈增长趋势，第四季度受到产业链主要产品价格下跌的影响，公司产品售价大幅下降，主营业务收入出现下滑，该业务于 2023 年第四季度计提大额存货跌价准备，其他季度光伏业务的存货跌价准备较为平稳，未发生明显波动。

3、存货跌价准备的计提依据和测算过程

公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，存货成本高于其可变现

净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

企业确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

公司存货可变现净值确认过程及方法如下：

(1) 原材料：正常生产流转的原材料，因产成品预计售价导致的存货跌价，根据产成品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本（在产品完工程度体现）、估计的销售费用（按照销售费用占同期收入的比重）后的金额，确定其可变现净值；对不可继续用于后续生产的按照市场处置价确认。

(2) 半成品：对于在生产使用过程中的在产品，以产成品售价为基础减去至完工时估计将要发生的成本（在产品完工程度体现）、估计的销售费用（按照销售费用占同期收入的比重）后的金额确认，确定其可变现净值；对于处于再加工状态的退货产品，按照调机片售价为基础，减去估计的销售费用以及达到可销售状态尚需投入的成本后的金额确认；对于在产品中已呆滞报废的物料，按照市场处置价确认。

(3) 库存商品：按照产品售价为基础减去估计的销售费用（按照销售费用占同期收入的比重）以及达到可销售状态尚需投入的成本后的金额，确定其可变现净值。

(4) 发出商品：对于发出商品有合同或订单的正常销售商品，按其签订的销售价格合理确定其可变现净值；对于发出商品中涉及期后退货的部分，在客户退回时，按照产成品中退货产品的预计售价确认。

2023 年第三季度，半导体业务部分在产品因客户检测设备更换，只能作为调机片处理，相比正常合格品订单售价大幅下降 80%；2024 年公司碳化硅衬底合格片的售价下降 20%-32%；2023 年第四季度，光伏业务售价出现大幅下降，（以某客户某规格产品报价为例，2023 年 12 月含税单价相比 2023 年 9 月下降约 40%）。而存货跌价准备的计提=存货结存数量*(单位成本-单位可变现净值)，单位可变现净值=不含税销售单价*(1-销售费用率)-达到可销售状态尚需投入的成本，售价的下降使得单位可变现净值下降，从而导致对应季度的存货跌价准备的计提大幅增加（以 2023 年第三季度被作为调机片处理的碳化硅衬底为例，

该规格因售价大幅下降 80%，导致单位可变现净值仅为其单位成本的约 11%，计提了存货跌价准备约 2.08 亿元）。

综上，公司 2023 年至 2024 年半年度存货跌价计提及时、充分。

(3) 结合现有业务开展情况，说明相关存货是否存在进一步减值风险，如是请充分提示

2024 年开始，公司半导体业务主要进行高规格 6 英寸和 8 英寸衬底的研发验证工作，截至 2024 年 9 月末，该业务尚未大规模生产供货，在新工艺参数调试过程中，产品良率不稳定，生产成本偏高。2024 年半年度，公司已按照在手订单的售价充分计提存货跌价准备。未来公司相关订单的售价会根据市场行情与客户协商情况进行调整，如果产品售价下跌或未来良率得不到有效提升，该业务相关存货仍存在进一步减值风险。

除半导体业务以外的其他业务，公司已于 2024 年半年度对相关存货按照在手订单的售价充分计提减值准备，目前暂无计提大额存货跌价准备的风险，但如果未来出现产品售价下跌或生产成本上升的情况，相关存货可能存在进一步的减值风险。

【年审会计师意见】

公司 2023 年末库存商品、半成品的构成合理，与公司实际情况相符。

公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，定期进行存货跌价准备的测算和计提。我们复核了公司期末存货跌价准备的计算过程及结果，其依据是充分的，具有合理性，公司 2023 年末存货跌价准备计提及时、充分。

2.公告显示，因存在部分原材料未及时入账、研发费用错误确认为半成品等情况，公司进行会计差错更正，将 2022 年归母净利润由 1.08 亿元调减为 0.79 亿元，将 2023 年一季度、半年度、三季度归母净利润分别由-0.39 亿元、-0.68 亿元、-0.52 亿元调减为-0.76 亿元、-1.27 亿元、-2.91 亿元，上述调整对当期归母净利润影响重大。2023 年，公司研发费用 3.60 亿元，同比大幅增长 167.48%；2024 年上半年，公司研发费用 1.36 亿元，同比继续增长 7.85%。

请公司补充披露：（1）未及时入账原材料的具体情况，包括原材料名称、账面价值、主要用途、供应商基本信息、款项支付及货物交付时点、实际存放和最终使用情况，并说明未及时入账的具体原因；（2）研发费用误确认为半成

品的具体情况，包括确认的半成品名称、账面价值、形成时点，并结合研发过程和实际核算情况说明未能准确计量研发费用的具体原因；（3）2023 年以来研发费用大幅增长的原因、主要用途及流向、形成的具体成果或效益，说明是否存在其他费用核算不准确的情形；（4）结合上述情况，说明公司内部控制是否存在重大缺陷及具体整改措施。请年审会计师发表意见。

【公司回复】

（1）未及时入账原材料的具体情况，包括原材料名称、账面价值、主要用途、供应商基本信息、款项支付及货物交付时点、实际存放和最终使用情况，并说明未及时入账的具体原因

公司未及时入账原材料的具体情况如下：

单位：万元

原材料名称	账面价值	主要用途	供应商基本信息	款项支付时点	货物交付时点	实际存放和最终使用情况
碳化硅晶体 150	315.00	碳化硅衬底相关生产	湖州华与非进出口有限公司	2022 年 8 月	2022 年 8 月	于 2022 年 8 月被生产使用
	315.00			2022 年 8 月	2022 年 11 月、2022 年 12 月	于 2022 年 11 月、2022 年 12 月被生产使用
碳化硅籽晶 153	44.00	碳化硅衬底相关研发		2022 年 8 月	2022 年 8 月	于 2022 年 8 月被研发使用
碳化硅晶体 150	325.28	碳化硅衬底相关生产		2022 年 10 月	2022 年 10 月	于 2022 年 10 月被生产使用
碳化硅籽晶 153		碳化硅衬底相关研发				于 2022 年 10 月被研发使用
碳化硅籽晶 155						
碳化硅晶体 150	359.50	碳化硅衬底相关生产		2022 年 10 月	2022 年 10 月	于 2022 年 10 月被生产使用
碳化硅晶体 8 寸	7.00	碳化硅衬底相关研发		2022 年 10 月	2022 年 10 月	于 2022 年 10 月被研发使用
碳化硅籽晶 153	164.18	碳化硅衬底相关研发		2022 年 11 月	2022 年 11 月	于 2022 年 11 月被研发使用
碳化硅籽晶 155		碳化硅衬底相关研发				
碳化硅晶体 150	371.55	碳化硅衬底相关生产		2022 年 11 月	2022 年 10 月、2022 年 11 月	于 2022 年 10 月、2022 年 11 月被生产使用
碳化硅晶体 150	448.81	碳化硅衬底相关生产		2022 年 12 月	2022 年 11 月、2022 年 12 月	于 2022 年 11 月、2022 年 12 月被生产使用
碳化硅籽晶 153	3.53	碳化硅衬底相关研发		2022 年 12 月	2022 年 12 月	于 2022 年 12 月被研发使用
碳化硅晶体	365.92	碳化硅衬底		2023 年 2 月	2023 年 2 月	于 2023 年 2 月

150		相关生产				被生产使用
碳化硅籽晶153	71.63	碳化硅衬底相关研发		2023年2月	2023年2月	于2023年2月被研发使用
碳化硅晶体150	389.34	碳化硅衬底相关生产		2023年3月	2023年3月	于2023年3月被生产使用
碳化硅籽晶153	62.33	碳化硅衬底相关研发		2023年3月	2023年3月	于2023年3月被研发使用
碳化硅晶体150	360.82	碳化硅衬底相关生产		2023年3月	2023年5月	于2023年5月被生产使用
碳化硅晶体150	470.64	碳化硅衬底相关生产		2023年3月	2023年3月	于2023年3月被生产使用
碳化硅籽晶153	74.49	碳化硅衬底相关研发		2023年3月	2023年3月	于2023年3月被研发使用
碳化硅晶体150	1,061.38	碳化硅衬底相关生产		2023年8月	2023年8月	于2023年8月被生产使用
碳化硅籽晶153	177.60	碳化硅衬底相关研发		2023年8月	2023年8月	于2023年8月被研发使用
碳化硅籽晶200 D级	74.43	碳化硅衬底相关研发		2023年8月	2023年8月	于2023年8月被研发使用
碳化硅晶体150	886.81	碳化硅衬底相关生产		2023年8月	2023年8月	于2023年8月被生产使用
碳化硅籽晶160	521.83	碳化硅衬底相关研发		2023年8月	2023年8月	于2023年8月被研发使用
碳化硅粉	16.81	碳化硅衬底相关研发		2023年8月	2023年8月	于2023年8月被研发使用
碳化硅晶体150	613.66	碳化硅衬底相关生产	上海纽卡帕科技有限公司	2023年9月	2023年8月	于2023年8月被生产使用
碳化硅籽晶160	623.46	碳化硅衬底相关研发		2023年9月	2023年8月	于2023年9月被研发使用
碳化硅籽晶200 P级	43.05	碳化硅衬底相关研发		2023年9月	2023年8月	于2023年9月被研发使用
碳化硅籽晶200 D级	197.37	碳化硅衬底相关研发		2023年9月	2023年8月	于2023年9月被研发使用
钨粉	38.28	钨丝金刚线相关研发	湖州华与非进出口有限公司	2022年11月	2022年11月	于2023年第一季度被研发使用
钨粉	70.76	钨丝金刚线相关研发		2022年12月	2022年12月	于2023年第一季度被研发使用
拉丝石墨乳						
氧化镧						
氢氧化镧	0.77	钨丝金刚线相关研发		2022年12月	2022年12月	于2023年第一季度被研发使用
氢氧化镧	0.77	钨丝金刚线相关研发		2023年1月	2023年1月	于2023年第一季度被研发使用
氧化镧	0.08	钨丝金刚线相关研发	2023年1月	2023年1月	于2023年第一季度被研发使用	
氧化镧	0.06	钨丝金刚线		2023年3月	2023年3月	于2023年第一

		相关研发				季度被研发使用
拉丝石墨乳	0.23	钨丝金刚线相关研发		2023年3月	2023年3月	于2023年第一季度被研发使用

公司子公司湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）分别于2022年9月、2023年1月与下游客户T签订6英寸碳化硅衬底销售合同，约定在2023年底前应交付6英寸碳化硅衬底合计超15万片。但公司自有长晶产能无法满足订单及研发需求，故公司外购一部分碳化硅晶体、籽晶，进行后道切磨抛加工，公司未将该部分原材料及时入账。直至2023年底，公司已确定无法完成上述合同的交付计划，故于2024年1月与客户签订补充协议明确违约责任和后续合作事宜。

2022年底2023年初，公司光伏业务中的钨丝金刚石切割线正在研发中，基于商业考量，公司不便让竞争对手知晓公司在进行钨的冶炼研究，故通过湖州华与非进出口有限公司这家贸易公司购买钨粉、氧化镧等原材料，因供应商未及时开票给公司且金额较小，原材料未及时暂估入账。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对公司前期会计差错进行更正，追溯调整了上述事项影响的存货及成本费用等相关会计报表项目。

（2）研发费用误确认为半成品的具体情况，包括确认的半成品名称、账面价值、形成时点，并结合研发过程和实际核算情况说明未能准确计量研发费用的具体原因

1、公司各报告期追溯调整为研发费用的半成品的具体情况如下：

单位：万元

报告期	半成品名称	账面价值	形成时点
2022年度	碳化硅晶锭（料号 B161-1001512-01F）	365.36	2022年4月
	碳化硅晶锭（料号 B111-1001020-02F）	32.00	2022年5月
	碳化硅晶体（料号 YB162-0000600-01F）	1,204.28	2022年12月
	碳化硅晶体（料号 B162-0000600-01F）	192.90	2022年12月
2023年第一季度	碳化硅晶体（料号 B162-0000600-01F）	64.26	2023年1月
2023年第二季度	碳化硅晶锭（料号 B161-1001512-01F）	664.29	2023年4月
		1,328.57	2023年5月
	衬底线切片（料号 YB163-0005049-01F）	1,829.83	2023年6月
2023年第三季度	碳化硅晶锭（料号 B161-1001512-01F）	431.79	2023年7月
		631.07	2023年8月
		1,395.00	2023年9月

2、未能准确计量研发费用的具体原因

2022 年至今，公司半导体业务主要进行 6 英寸导电型碳化硅衬底片研发及相关工艺的优化。2022 年，公司陆续将样品送去下游客户 T 做验证，在客户端反馈良好，2022 年 9 月，东尼半导体与下游客户 T 签订 2 万片 6 英寸碳化硅衬底的订单，该业务 2022 年度实现营业收入 1,676.56 万元。2023 年第一季度，研发部门通过调整籽晶在长晶炉中的位置、长晶功率以及保温等方式，保证生长条件的稳定性，改善晶片外观问题，2023 年 1 月，东尼半导体与下游客户 T 签订 13.5 万片 6 英寸碳化硅衬底的年度订单。2023 年第二季度，研发部门通过软件模拟的方式，优化热场结构设计，保证温度分布的均匀性，改善位错问题。2023 年第三季度，长晶工艺重新开发，以应对检测设备更换的问题，进行 SF 良率的改善。2023 年度，半导体业务实现营业收入 12,940.92 万元。2024 年开始碳化硅衬底材料的主要需求又从 SBD 级发展到技术指标要求更高的 MOS 级，半导体业务 2024 年上半年主要进行高规格 6 英寸和 8 英寸衬底的研发验证工作，半年度实现营业收入 4,129.34 万元。

公司自 2022 年 1 月 1 日起按照财政部发布的企业会计准则解释第 15 号，对半导体业务研发过程中产出的研发制品，在完工入库时按照实际研发耗用的材料成本计量其成本并确认为存货，同时冲减研发费用。2023 年 6 月，东尼半导体与下游客户 T 沟通发现，双方产品检测设备不同导致 SF 的判断标准不一致，使得得出的 TUA 数据不一致，并于 2023 年 7 月邮件确认上述问题引起的 2023 年交付计划的差异不视为违约。问题出现后，公司与下游客户 T 关于技术指标检测、设备工艺调整等一直保持沟通，直至 2024 年 1 月，与下游客户 T 签订补充协议对违约责任和后续合作事宜做了相关约定，具体情况详见公司于 2024 年 1 月披露的《东尼电子关于重大合同的进展公告》及补充公告（公告编号：2024-002、2024-003）。至此，公司明确所涉产品预计在后期存在无法使用的可能，基于谨慎性原则，公司对 2022 年度、2023 年第一至第三季度在研发阶段转入的有关半成品追溯调整为研发费用。

(3) 2023 年以来研发费用大幅增长的原因、主要用途及流向、形成的具体成果或效益，说明是否存在其他费用核算不准确的情形

1、公司 2023 年以来研发费用的具体情况如下：

单位：万元

主要用途	2024 年半	2023 年度	形成的具体成果或效益
------	---------	---------	------------

及流向	年度研发费用	研发费用	同比变动 (%)	
消费电子	1,753.31	5,368.04	26.57	2023 年至 2024 年半年度，该业务取得专利 11 项(其中发明专利 1 项、实用新型 10 项)。主要针对无线充电隔磁材料的配套研发改进，根据国际大客户的产品迭代要求，改造优化各制程工序的模治具及自动化设备的设计方案及运营稳定性，对消费电子业务 2023 年度毛利率提升、2024 年半年度营收和毛利增长起到促进作用。
光伏	4,834.13	9,660.68	225.61	2023 年至 2024 年半年度，该业务取得专利 2 项(其中发明专利 1 项、实用新型 1 项)。研发进行中，尚未形成显著效益。
新能源	1,849.02	4,679.81	112.42	2023 年至 2024 年半年度，该业务取得专利 20 项(其中发明专利 2 项、实用新型 18 项)。主要针对新项目柔性线路板相关产品和工艺的研发，解决产品式样及工艺设计、端子压接、集成母排直连等技术领域的一系列问题，并研发了直焊连接技术和铝基导体 FPC,对 2024 年半年度部分新能源客户的定点项目批量供货、营收大幅增长起到促进作用。
医疗	199.35	478.96	25.23	2023 年至 2024 年半年度，该业务取得专利 4 项(其中发明专利 1 项、实用新型 3 项)。主要针对已有产品的配套研发改进，对医疗业务 2023 年度毛利率提升、2024 年半年度营收和毛利增长起到促进作用。
半导体	4,947.59	15,839.62	330.94	2023 年至 2024 年半年度，该业务取得专利 7 项(其中发明专利 2 项、实用新型 5 项)。研发进行中，尚未形成显著效益。
总计	13,583.41	36,027.12	167.48	/

2、公司 2023 年以来研发费用大幅增长，主要系半导体、光伏和新能源业务的研发投入大幅增加所致，具体原因如下：

(1) 半导体业务：碳化硅衬底材料为第三代半导体的核心材料之一，尚处于快速发展阶段，技术指标更新较快，质量要求不断提高，且公司 2023 年 6 月又发现主要下游客户的检测设备从 SICA88 转为 candela8520,由于两款检测设备的检测方式不同，对 SF 的检测结果不一致，导致产品规格等级下降，为满足客户新检测设备的要求，需重新开发，而 2024 年开始碳化硅衬底材料的主要需求又从 SBD 级发展到技术指标要求更高的 MOS 级。为应对上述变化，满足客户要求，公司需不断提升改进产品工艺，长期持续开展大量研发工作，并经过小批量、中批量、大批量的技术数据积累，以完成各工艺环节的精准设计，故半导体业务的研发投入大幅增长。

(2)光伏业务:近年来光伏用金刚石切割线整体表现为细线化的发展趋势,对于下游客户,更细的线径意味着更小的切割损耗、更高的出片率,而公司则需要在保持拉断力的前提下,尽量减小线径。为了顺应这一趋势,公司进行传统钢线金刚石切割线的细线化研发的同时,投入更细线径的钨丝金刚石切割线从冶炼、锻造、拉丝到上砂的全产业链研发,故光伏业务的研发投入大幅增长。

(3) 新能源业务:公司看好新能源汽车行业的发展,为扩展该业务的产品类型,公司引进新团队,投入线路板项目的研发,该项目主要包括柔性线路板(FPC)、电芯连接系统(CCS)两大产品。2023年以来,该项目已陆续拿到逾20个定点项目,均需进行研发验证,故新能源业务的研发投入大幅增长。2024年上半年,该业务部分客户的定点项目已批量供货,营收大幅增长。

3、除公司于《东尼电子关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2024-018)、《东尼电子关于前期会计差错更正的补充公告》(公告编号:2024-021)中追溯调整的财务数据外,公司不存在其他费用核算不准确的情形。

(4) 结合上述情况,说明公司内部控制是否存在重大缺陷及具体整改措施

公司内部控制不存在重大缺陷。原因如下:

公司因自有长晶产能无法满足订单及研发需求,外购一部分碳化硅晶体、籽晶,进行后道切磨抛加工,公司未将该部分原材料及时入账。2023年度因客户发生检测设备的变更导致前期研发过程中产出的晶体、晶锭预计后期存在无法使用的可能,因此公司将研发阶段转入的有关半成品追溯调整为研发费用。公司自2023年11月22日之后对采购循环中的控制缺陷进行了整改,整改后再无上述情况存在,且整改后的控制运行了足够长的时间;公司还聘请了第三方机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对信息系统进行了审计,未发现公司信息系统内部控制管理存在重大缺陷的情况。

针对上述情况,公司2024年4月对关联交易事项进行了补充确认,并披露了《东尼电子关于前期会计差错更正的公告》及相关补充公告,追溯调整了受上述事项影响的相关财务数据。上述调整已包含在公司2023年度财务报告,不影响2023年度财务报告的认定。

公司发现存在上述情况后,公司及有关责任人对上述问题高度重视,深刻反思,认真吸取经验教训。

公司要求控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及相关人

员认真学习《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，进一步强化会计核算的严谨性，夯实财务核算基础工作，加强与业务部门的沟通，充分获取信息以准确反映业务实质，及时谨慎进行会计估计和会计处理，提高财务核算的准确性和及时性，确保会计核算和财务管理的规范性，提升公司规范运作水平和财务信息披露质量，避免此类事件再次发生。

公司及相关责任人员在认真检视公司内部控制体系的建设情况以及实际执行过程中存在的薄弱环节后，根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定，健全内部控制规范体系，不断改善内部控制薄弱环节，加强控股股东的合规意识，加强原材料入库和成本核算的流程管控与监督，加强财务部、董事会办公室与业务部门的沟通，确保公司内部控制制度的有效运作。

公司将持续提升内部控制管理水平，强化内部控制监督，跟进内部控制制度的执行情况和执行效果，根据监督检查的情况，不断提出意见和建议，切实完善公司治理，确保公司制度、办法、业务流程运行有效，推动公司科学决策、稳健经营，促进公司建立健全更为科学、规范的内部治理长效机制。公司还将强化全员合规意识，深化对法律法规及规范性文件的学习，提升有关部门及相关人员对规则的理解和执行能力，不断提升规范运作水平和信息披露质量。

【年审会计师意见】

公司 2023 年以来研发费用大幅增长，主要是半导体、光伏和新能源业务的研发投入大幅增加所致，与公司的自身发展规划相适应，具有合理性，不存在其他费用核算不准确的情形。

公司 2022 年 9 月、2023 年 1 月与下游客户 T 签订 6 英寸碳化硅衬底销售合同，约定在 2023 年底前应交付 6 英寸碳化硅衬底合计超 15 万片，但公司自有长晶产能无法满足订单及研发需求，故公司外购一部分碳化硅晶体、籽晶，进行后道切磨抛加工，公司未将该部分原材料及时入账。对于研发过程中产出的研发制品，公司在完工入库时按照实际研发耗用的材料成本计量其成本并确认为存货，同时冲减研发费用。由于 2023 年度客户发生检测设备的变更导致该部分晶体、

晶锭预计后期存在无法使用的可能，因此将研发入库的半成品结转研发费用。上述情形与公司 2023 年财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷，具体如下：

1、针对上述事项，公司 2022 年度、2023 年一季度、半年度和三季度已进行整改并进行会计差错更正，并与 2023 年年报一并审议通过并公告；上述事项的调整已包含在 2023 年度财务报告中，不影响 2023 年度财务报告的认定。

2、公司 2023 年最后一次未及时入账采购日期为 2023 年 11 月 22 日，公司采购频率为多频次，甚至每天采购。根据企业内部控制审计指引（财会〔2010〕11 号）以及《企业内部控制审计指引实施意见》（会协〔2011〕66 号）规定，公司对存在缺陷的控制进行了整改，整改后的控制运行了足够长的时间（2023 年 11 月 23 日-内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日），满足整改后控制运行的最短期间和最少测试数量，可以使项目组得出控制运行有效的审计结论。

3、公司已聘请了第三方机构立信会计师事务所对其信息系统进行了审计，测试结论为：公司的信息系统内部控制管理总体符合规范中的相关标准，未发现公司信息系统内部控制管理存在重大缺陷的情况。财务审计团队可采用信息系统信赖策略开展实质性程序测试工作。

针对发现的上述问题，项目组审计人员调整了审计计划，增加了包括对下游 T 客户访谈；访谈东尼半导体项目部技术总监、生产课长和东尼电子董事办副主任，了解该部分未入账原材料的来源；穿透核查关联方代垫资金采购的上游供应商以及最终供应商；实地走访上游供应商；要求公司聘请第三方进行信息系统审计；增加采购循环样本量。

我们认为，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.公告显示，2024 年 6 月末，公司固定资产账面价值 18.61 亿元，占总资产比例高达 35.08%。2022 年至 2024 年 6 月末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金合计高达 16.61 亿元，同期公司经营活动产生的现金流量净额合计仅为-2.01 亿元。此外，2023 年 6 月末，公司其他非流动资产高达 4.61 亿元，同比增加 82.45%，主要系设备预付款，至 2024 年 6 月末下降至 0.24 亿元。

请公司补充披露：（1）2023 年末、2024 年 6 月末公司主要固定资产的基本

情况，包括固定资产名称、所在具体位置、形成时间、取得方式、主要用途、实际使用情况，结合公司所处行业竞争格局、自身发展规划、主要产品销售情况说明长期大额购建固定资产的原因及合理性，是否与实现效益相匹配；（2）2022 年以来为购建前述资产所支付现金的主要交易对象和付款方式，公司及关联方是否与其存在关联关系或其他利益安排，支付资金是否存在流向公司关联方的情形；（3）2023 年 6 月末设备预付款的交易手方名称、与公司关联关系、交易价格、款项支付时点、期后设备交付情况，是否存在售后退回情形，说明相关支付款项是否最终流向关联方。请独立董事对问题（2）（3）发表意见，请年审会计师发表意见。

【公司回复】

（1）2023 年末、2024 年 6 月末公司主要固定资产的基本情况，包括固定资产名称、所在具体位置、形成时间、取得方式、主要用途、实际使用情况，结合公司所处行业竞争格局、自身发展规划、主要产品销售情况说明长期大额购建固定资产的原因及合理性，是否与实现效益相匹配

1、公司 2023 年末、2024 年 6 月末主要固定资产的基本情况如下：

单位：万元

报告期	固定资产名称	类型	账面原值	所在具体位置	形成时间	取得方式	主要用途	实际使用情况
2024 年 6 月末	消费电子业务固定资产	机器设备、检测设备	47,475.58	东尼产业园一期、二期，东尼新材南京分公司	2008 年 5 月 -2024 年 6 月	外购	生产、研发消费电子业务相关产品	正常使用
	光伏业务固定资产	机器设备、检测设备	51,065.94	东尼产业园一期、二期、三期、四期，龙鹰厂区，轧村厂区	2010 年 2 月 -2024 年 6 月	外购	生产、研发光伏业务相关产品	正常使用
	新能源业务固定资产	机器设备、检测设备	25,498.02	东尼产业园一期、二期、四期	2015 年 11 月 -2024 年 6 月	外购	生产、研发新能源业务相关产品	正常使用
	医疗业务固定资产	机器设备、检测设备	4,450.08	东尼产业园一期	2015 年 9 月 -2024 年 4 月	外购	生产、研发医疗业务相关产品	正常使用
	半导体业务固定资产	机器设备、检测设备	87,831.39	东尼产业园一期、二期、五期，龙鹰厂区	2018 年 1 月 -2024 年 6 月	外购	生产、研发半导体业务相关产品	正常使用
	公共固定资产	机器设备、检测设备	1,274.25	东尼产业园一期、二期、三期，东尼特材厂区，轧村厂区	2014 年 2 月 -2024 年 4 月	外购	业务部门、职能部门共用	正常使用

	总计	/	217,595.27	/	/	/	/	/
2023 年末	消费电子业务固定资产	机器设备、检测设备	47,492.56	东尼产业园一期、二期，东尼新材南京分公司	2008年5月-2023年12月	外购	生产、研发消费电子业务相关产品	正常使用
	光伏业务固定资产	机器设备、检测设备	50,228.09	东尼产业园一期、二期、三期、四期，龙鹰厂区，轧村厂区	2010年2月-2023年12月	外购	生产、研发光伏业务相关产品	正常使用
	新能源业务固定资产	机器设备、检测设备	21,928.58	东尼产业园一期、二期、四期	2015年11月-2023年12月	外购	生产、研发新能源业务相关产品	正常使用
	医疗业务固定资产	机器设备、检测设备	4,343.75	东尼产业园一期	2015年9月-2023年12月	外购	生产、研发医疗业务相关产品	正常使用
	半导体业务固定资产	机器设备、检测设备	79,613.10	东尼产业园一期、二期、五期，龙鹰厂区	2018年1月-2023年12月	外购	生产、研发半导体业务相关产品	正常使用
	公共固定资产	机器设备、检测设备	1,273.54	东尼产业园一期、二期、三期，东尼特材厂区，轧村厂区	2014年2月-2023年11月	外购	业务部门、职能部门共用	正常使用
	总计	/	204,879.62	/	/	/	/	/

2、公司 2023 年、2024 年半年度主要产品的固定资产账面原值及销售情况

如下：

单位：万元

报告期	主要产品	固定资产		主营业务收入	
		期末账面原值	相比期初增减(%)	金额	同比增减(%)
2024 年半年度	消费电子	47,475.58	-0.04	37,833.92	29.67
	光伏	51,065.94	1.67	12,946.88	-45.04
	新能源	25,498.02	16.28	13,874.31	146.00
	医疗	4,450.08	2.45	6,192.60	14.90
	半导体	87,831.39	10.32	4,129.34	-62.22
2023 年度	消费电子	47,492.56	3.63	87,329.62	-18.64
	光伏	50,228.09	32.04	45,160.68	0.79
	新能源	21,928.58	92.65	14,825.19	37.84
	医疗	4,343.75	13.02	11,233.85	-21.46
	半导体	79,613.10	116.14	12,940.92	619.74

2023 年以来，公司固定资产的购建主要是在半导体、新能源和光伏业务，其中半导体业务处于研发验证阶段，尚未实现显著效益；新能源业务随着固定资产的购建，2024 年上半年开始实现显著效益，营收大幅增长；光伏业务虽投入设备用于研发，但受制于产业链主要产品价格下跌的影响业绩下滑。具体分析如下：

碳化硅行业系国家重点扶持的高科技行业，碳化硅衬底材料为第三代半导体

的核心材料之一，市场前景广阔，而碳化硅研发生产工艺复杂，技术指标不断更新，质量要求不断提高，需要设备种类多，数量大、金额高，为应对产品研发和量产，公司需提前购买大量固定资产。公司半导体业务不断提升改进工艺，大量进行研发实验，并于 2023 年初开始批量供货，2023 年 6 月公司发现主要下游客户的检测设备从 SICA88 转为 candela8520，由于两款检测设备的检测方式不同，对 SF 的检测结果不一致，导致产品规格等级下降，为满足客户新检测设备的要求，需重新开发，而 2024 年开始碳化硅衬底材料的主要需求又从 SBD 级发展到技术指标要求更高的 MOS 级，公司 2024 年开始主要进行高规格 6 英寸和 8 英寸衬底的研发验证工作，尚未实现显著效益。

公司看好新能源汽车行业的发展，为扩展该业务的产品类型，公司引进新团队，投入线路板项目的研发，该项目 2023 年主要处于研发验证和量产前期准备阶段，因该项目为公司的新产品，虽与现有业务有协同效应，但仍需购入机器设备等固定资产以支持研发生产。2024 年上半年，部分客户的定点项目开始批量供货，营收大幅增长。

近年来光伏用金刚石切割线整体表现为细线化的发展趋势，为顺应这一趋势，公司进行传统钢线金刚石切割线的细线化研发的同时，投入更细线径的钨丝金刚石切割线从冶炼、锻造、拉丝到上砂的全产业链研发，上述研发均需投入固定资产。2024 年上半年，光伏业务受制于产业链主要产品价格下跌的影响，业务收缩，业绩下滑。

(2) 2022 年以来为购建前述资产所支付现金的主要交易对象和付款方式，公司及关联方是否与其存在关联关系或其他利益安排，支付资金是否存在流向公司关联方的情形

公司 2022 年以来为购建前述资产所支付现金的前二十大交易对象和付款方式如下：

单位：万元

序号	交易对象	2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日现金支付总额	付款方式
1	苏州优品半导体科技股份有限公司	35,470.00	电汇转账
2	浙江磊卓机械有限公司	26,245.47	电汇转账、承兑汇票
3	广东唐古环境科技有限公司	9,106.93	电汇转账
4	浙江玉泉环境工程有限公司	5,066.86	电汇转账、承兑汇票
5	青岛高测科技股份有限公司	4,712.40	电汇转账、承兑汇票

6	铭乾科技（天津）有限公司	4,451.07	电汇转账
7	辛耘企业股份有限公司	3,895.78	电汇转账
8	南京晶升装备股份有限公司	3,597.91	电汇转账
9	湖南瑞翼能源股份有限公司南京分公司	3,447.94	电汇转账、承兑汇票
10	浙江大东吴杭萧绿建科技有限公司	3,029.81	电汇转账、承兑汇票
11	宜昌给立金刚石工业有限公司	3,006.98	电汇转账、承兑汇票
12	湖州好汉帮建设工程有限公司	2,696.98	电汇转账、承兑汇票
13	上海立净工程建设有限公司	2,089.00	电汇转账、承兑汇票
14	Tokyo Seimitsu Co., Ltd.	1,851.87	电汇转账
15	湖州电力设计院有限公司	1,684.74	电汇转账
16	苏州苏氢制氢设备有限公司	1,606.21	电汇转账
17	迪思科科技（中国）有限公司	1,597.77	电汇转账
18	新耕（上海）贸易有限公司	1,462.88	电汇转账
19	扬帆半导体（江苏）有限公司	1,446.50	电汇转账
20	杭州青山环保科技有限公司	1,407.10	电汇转账
合计		117,874.17	/

公司及关联方与上述主要交易对象均不存在关联关系或其他利益安排，支付资金不存在流向公司关联方的情形。

（3）2023年6月末设备预付款的交易对手方名称、与公司关联关系、交易价格、款项支付时点、期后设备交付情况，是否存在售后退回情形，说明相关支付款项是否最终流向关联方

公司2023年6月末前二十大设备预付款的交易对象具体情况如下：

单位：万元

序号	交易对手方名称	是否与公司存在关联关系	设备预付款期末余额	交易价格	款项支付时点	截至2024年9月末设备交付情况	是否存在售后退回情形
1	浙江磊卓机械有限公司	否	11,524.76	生长炉、上砂机改造，协商定价，合同金额 27,481.62 万元	2022年11月，2023年3月、4月、5月、6月	2023年7月-2024年8月交付，未验收	否
2	广东唐古环境科技有限公司	否	6,134.83	纯水系统，协商定价，合同金额 10,751.70 万元	2022年8月、11月，2023年2月、3月、4月	2023年7月交付，未验收	否
3	铭乾科技（天津）有限公司	否	4,440.90	缺陷检测设备 SICA88，协商定价，合同金额 12,068.40 万元	2023年1月、4月	2023年9月-2023年10月部分交付，2024年3月-2024年9月验收	否
4	无锡来诺斯科技有限公司	否	3,761.20	金刚线16线电镀设备，协商定价，合同金额 7,020.00	2023年4月	2023年8月交付，2023年10月部分验收	否

				万元			
5	宜昌给立金刚石工业有限公司	否	1,787.50	拉丝机、拉丝机改造、加热炉改造, 协商定价, 合同金额 6,378.69 万元	2023 年 5 月	2023 年 7 月交付, 2024 年 8 月验收	否
6	新耕(上海)贸易有限公司	否	1,430.71	表面缺陷检测仪 Candela8520、在线原子力显微镜, 协商定价, 合同金额 1,589.68 万元	2022 年 6 月, 2023 年 4 月、6 月	2023 年 7 月-2023 年 9 月交付, 2023 年 11 月-2024 年 3 月验收	否
7	青岛高测科技股份有限公司	否	1,216.00	金刚线切割碳化硅专机, 协商定价, 合同金额 4,920.00 万元	2023 年 5 月、6 月	2023 年 7 月-2023 年 9 月交付, 2023 年 11 月验收	否
8	迪思科科技(中国)有限公司	否	1,170.58	研磨机、研磨切片机, 协商定价, 合同金额 1,300.64 万元	2023 年 2 月、5 月	2023 年 7 月交付, 2023 年 10 月验收	否
9	苏州苏氢制氢设备有限公司	否	957.69	氢气站, 协商定价, 合同金额 1,350.00 万元	2023 年 1 月、4 月、5 月	2023 年 3 月交付, 未验收	否
10	大正华嘉科技(香港)有限公司	否	854.10	全自动清洗机、酸清洗机, 协商定价, 合同金额 949.00 万元	2022 年 8 月, 2023 年 2 月、6 月	2023 年 7 月交付, 2024 年 1 月部分验收	否
11	弘元绿色能源股份有限公司	否	810.00	碳化硅切片机, 协商定价, 合同金额 900.00 万元	2022 年 5 月、7 月、10 月, 2023 年 2 月	2022 年 7 月-2023 年 2 月交付, 2023 年 10 月验收	否
12	西安博莱炉业科技股份有限公司	否	659.87	烧结炉、加热炉, 协商定价, 合同金额 2,305.60 万元	2022 年 6 月、10 月、12 月, 2023 年 5 月	2023 年 10 月部分交付, 未验收	否
13	广州市鸿辉电工机械有限公司	否	644.21	高速绞线机, 协商定价, 合同金额 1,820.88 万元	2023 年 3 月、5 月、7 月	2023 年 5 月交付, 未验收	否
14	广东德睿成自动化有限公司	否	545.00	动力极耳成型机, 协商定价, 合同金额 2,180.00 万元	2023 年 4 月、5 月	2023 年 4 月交付, 2024 年 1 月验收	否
15	南京晶升装备股份有限公司	否	541.80	长晶炉, 协商定价, 合同金额 3,960.30 万元	2023 年 3 月、4 月、5 月、6 月	2023 年 7 月-2023 年 9 月交付, 未验收	否
16	苏州辰轩光电科技有限公司	否	538.18	单面抛光机、全自动单面清洗机、陶瓷盘清洗贴片一体机、贴胶机, 协商定价, 合同金额 2,354.96 万元	2022 年 11 月, 2023 年 4 月、5 月、6 月	2023 年 7 月-2024 年 4 月部分交付, 2023 年 10 月部分验收	否
17	苏州优晶半导体科技股份有限公司	否	485.00	碳化硅生长炉, 协商定价, 合同金额 54,000.00 万元	2023 年 5 月、6 月	2023 年 7 月-2023 年 8 月交付, 2024 年 1	否

						月部分验收	
18	上海聚勒实业发展有限公司	否	471.64	籽晶键合炉、晶体退火炉、腐蚀炉，协商定价，合同金额 1,154.60 万元	2021 年 10 月，2022 年 3 月、5 月、7 月、9 月，2023 年 2 月、4 月、6 月	2022 年 3 月-2023 年 9 月交付，2023 年 7 月-2023 年 12 月部分验收	否
19	杭州青山环保科技有限公司	否	402.10	供药系统/污水处理系统，协商定价，合同金额 804.20 万元	2023 年 6 月	2024 年 1 月交付，2024 年 1 月验收	否
20	苏州施密科微电子设备有限公司	否	330.00	全自动 RCA 清洗机，协商定价，合同金额 660.00 万元	2023 年 6 月	2024 年 1 月交付，未验收	否
合计		/	38,706.07	/	/	/	/

公司上述支付款项均不存在最终流向关联方的情形。

【独立董事意见】

针对问题（2），经向公司详细了解相关情况并认真审阅相关资料，我们一致认为：公司及关联方与购建前述资产所支付现金的主要交易对象均不存在关联关系或其他利益安排，支付资金不存在流向公司关联方的情形。

针对问题（3），在认真审阅相关资料，对合同进行核查后，我们一致认为：公司与 2023 年 6 月末设备预付款的交易对手方不存在关联关系，相关预付款不存在售后退回情形，支付款项不存在最终流向关联方的情形。

【年审会计师意见】

公司固定资产的购建主要是在半导体、新能源和光伏业务，与公司的自身发展规划相匹配。

公司半导体碳化硅业务的研发生产工艺复杂，技术指标不断更新，需要设备种类多、数量大；近年来光伏用金刚石切割线整体表现为细线化的发展趋势，公司为了顺应这一趋势，投入更细线径的钨丝金刚石切割线从冶炼、锻造、拉丝到上砂的全产业链研发。公司为应对上述业务研发和量产，公司需提前购买大量固定资产，效益的实现与固定资产的购建不完全匹配，存在滞后性。

公司 2022 年以来购建前述资产的主要支付方式为银行转账和承兑汇票。公司及关联方与上述主要交易对象均不存在关联关系或其他利益安排，支付资金不存在流向公司关联方的情形。

公司 2023 年设备预付款的交易对手与公司不存在关联关系，不存在售后退回的情形，支付款项不存在最终流向关联方的情形。

4.公告显示，2024年6月末，公司短期借款和长期借款期末余额分别高达3.16亿元、4.48亿元，均远高于公司货币资金期末账面价值0.98亿元。同期公司资产负债率为68.21%，同比大幅增加13.16个百分点。

请公司补充披露：结合目前日常生产经营资金需求、资产负债结构、偿债安排等情况，分析公司面临的流动性风险和偿债压力，并说明已采取或拟采取的应对措施。

【公司回复】

1、公司面临的流动性风险和偿债压力

(1) 日常生产经营资金需求

公司日常生产经营资金需求主要包括购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工及为职工支付的现金。根据2022年至2024年上半年的历史数据和生产经营安排，公司初步预计全年的日常生产经营资金需求在20亿元左右，其中下半年需求会高于上半年。公司2022年至2024年上半年的情况具体如下表：

单位：万元

日常生产经营资金需求	2024年 上半年	2023年 下半年	2023年 上半年	2022年 下半年	2022年 上半年
经营活动现金流出小计	72,115.22	124,589.11	94,602.22	101,088.16	97,358.62
其中：购买商品、接受 劳务支付的现金	54,369.06	107,253.00	77,922.12	85,787.92	82,461.28
支付给职工及为 职工支付的现金	13,415.11	13,972.08	11,254.19	11,014.18	9,094.57

(2) 资产负债结构

公司2023年度及2024年半年度的资产负债结构具体如下表：

单位：万元

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	163,990.68	30.92%	171,261.61	32.30%
非流动资产	366,431.12	69.08%	358,888.02	67.70%
资产合计	530,421.80	100.00%	530,149.63	100.00%
流动负债	277,929.42	76.82%	248,653.94	70.80%
非流动负债	83,868.51	23.18%	102,535.42	29.20%
负债合计	361,797.93	100.00%	351,189.36	100.00%

(3) 偿债安排

截至2024年6月30日，公司的有息负债合计202,413.83万元，主要包括短期借款28,292.64万元、长期借款117,683.91万元、其他融资款51,641.16万元、

租赁负债 4,796.12 万元。上述有息负债的偿债安排具体如下表：

单位：万元

还款时间	还款金额	还款项目
2024 下半年偿还	83,351.58	短期借款/长期借款/其他融资款/租赁负债
2025 上半年偿还	52,640.39	短期借款/长期借款/其他融资款/租赁负债
2025 下半年偿还	17,474.76	长期借款/其他融资款/租赁负债
2026 上半年偿还	18,740.48	长期借款/其他融资款/租赁负债
2026 下半年偿还	6,760.52	长期借款/其他融资款/租赁负债
2027 上半年偿还	3,970.60	长期借款/租赁负债
2027 下半年偿还	2,875.50	长期借款/租赁负债
2028 上半年偿还	2,850.00	长期借款
2028 下半年偿还	4,650.00	长期借款
2029 上半年偿还	1,500.00	长期借款
2029 下半年偿还	1,500.00	长期借款
2030 上半年偿还	1,500.00	长期借款
2030 下半年偿还	1,500.00	长期借款
2031 上半年偿还	1,550.00	长期借款
2031 下半年偿还	1,550.00	长期借款
合计	202,413.83	/

公司 2023 年末、2024 年 6 月末的流动负债均高于流动资产，2024 年 6 月末的有息负债合计 20.24 亿元，其中 13.60 亿元需在一年内偿还，占比 67.19%，公司虽通过运营管理等措施，2024 年上半年日常生产经营资金需求显著下降，但仍面临一定的流动性风险和偿债压力。

2、已采取或拟采取的应对措施

(1) 提高公司市场竞争力及盈利能力

2024 年以来，公司积极调整业务结构，针对能为公司带来稳定现金流的消费电子、医疗业务，提高市场拓展能力，扩大业务规模，释放产能，增强盈利能力，有效应对公司偿债压力。

(2) 合理选择融资方式

公司积极协调相关金融机构，维持银行现有授信额度，加大与金融机构、政府部门的沟通协调，争取低成本融资，进一步降低公司融资成本及偿还压力。公司信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与多家银行建立了长期、稳定的合作关系。目前，银行授信额度充足，可满足公司业务发展过程中的急需资金周转需求。

(3) 加强资金统筹

持续加强资金统筹，通过与供应商和客户的战略合作，加强供应链管理，通过合理设置合同支付条款和支付方式，将资金使用效益最大化。

(4) 建立动态流动性风险管控措施

通过持续性采集、分析、动态更新公司整体资金状况及使用计划，建立及时、有效的资金管理模式，对公司现金流使用及调配进行有效管控，通过整体把控公司及各子公司大额资金收支情况，及时发现流动性风险关键时点，统筹做好流动性平衡工作。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024年11月7日